



8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



HAF ฟิล์มติดด้วยการกระตุ้นด้วยความร้อน สามารถนำไฟฟ้าได้ในแกน z สีขุ่น หนา 40 ไมครอน

Product Description

tesa® HAF 8414 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน โปร่งแสง ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพและการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนเดียว
- สามารถใช้งานได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ PC การ์ด (DI)
- เหมาะกับพื้นผิว silver ink (RFID)

เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานของอนุภาค: 40 ไมครอน

คุณสมบัติ

- Chip module bonding and electrical connectivity in one step
- Good workability on all common implanting lines
- Suitable for PVC, ABS and PC cards (Dual Interface (D.I.) and contactless cards)
- Suitable for silver ink substrates and wire antenna
- Mean particle diameter: 40 μm

การใช้งาน

tesa® HAF 8414 ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเชื่อมไฟฟ้าที่มีความเสถียรและการเชื่อมติดที่ทนทาน การใช้งานหลักคือการฝังชิพในการ์ดแบบ Dual Interface (DI) และ strap attachment สำหรับ RFID tag

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|----------|
| • Backing | none | • Type of liner | glassine |
| • Type of adhesive | copolyamide | • Color | โปร่งแสง |

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด วัสดุ antenna ชิปโมดูลและรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า เวลาการติดขึ้นอยู่กับการส่งผ่านความร้อนของพื้นผิววัสดุที่ใช้ นอกจากนี้ เราขอแนะนำขั้นตอนการทำให้เย็นตัวลงโดยตรงหลังจากขั้นตอนการติด ควรใช้แรงกดจนอุณหภูมิฟิล์มลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิที่ทำให้ร้อนตัว (ประมาณ 110 °C)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของเครื่อง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08414>

8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การเคลือบติดเบื้องต้น:

ช่วงการติดเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูล การเคลือบที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ HAF 8414 เพื่อให้แน่ใจในการยึดเกาะที่ดีและค่าการนำไฟฟ้าที่ดีภายในขั้นตอนสุดท้าย

การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 130 - 150 °C
- แรงกดทับ 1.5 - 3 บาร์
- เวลา 1 - 2.5 ม./นาที.

2. การติดตัวนำไฟฟ้า:

ระหว่างการฝังโมดูล โมดูลที่ถูกติดเทปไว้เบื้องต้นจะถูก die-cut

จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าไปในหลุมของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ implanting line ซึ่งสามารถใช้วิธีการกดทับขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน ปัจจุบันเครื่องฝังส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายขั้นตอน

การตั้งค่าเครื่อง - ขั้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ 160 – 220 °C
- แรงกด 65 - 130 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

การแบบกดทับหลายครั้ง (การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 - 130N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที / 3 x 0.5 วินาที

¹อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน มีแนะนำการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC 180 – 190 ° C

ABS 180 – 190 ° C

PET 190 – 200 ° C

PC 200 – 220 ° C

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาวะการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF



8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08414>